

<<电子装配与调试工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子装配与调试工艺>>

13位ISBN编号：9787564100872

10位ISBN编号：7564100877

出版时间：2005-8

出版时间：东南大学出版社

作者：金明

页数：260

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子装配与调试工艺>>

内容概要

本书是一本介绍电子装配与调试的实训课教材，全书共分8章，分别讲述了常用元器件知识、手工焊接知识、自动焊接知识、装配工艺基础、常用工艺文件与整机装配工艺、调试与检测基础、举例调试方法以及综合练习等，并附有《电子设备装接工》、《无线电调试工》的国家标准。

本书的特点是实用、通俗、易懂，同时兼顾了电子特种行业技能鉴定，去除了烦琐的理论说教，用最直观的实例，最通俗的语言，说明操作的步骤、过程与技巧，能满足一般工程技术人员的需要。

由于各校情况不同，本课程教学时数可根据具体情况灵活安排，但一般情况下建议教学参考时数为64学时左右。

本书可作为高职高专院校电子信息工程、无线电、通信设备制造、广播电视工程及通信工程等电子与通信专业学生使用，也可供电子与通信领域内的工程技术人员培训、考级或自修参考。

书籍目录

1 常用无线电元器件 1.1 电阻器 1.1.1 电阻器的作用和分类 1.1.2 电阻器的主要参数 1.1.3 电阻器、电位器型号的命名 1.1.4 电阻器典型参数的标识方法 1.1.5 电阻器好坏的判别 1.1.6 其他 1.2 电容器 1.2.1 电容器的作用与类别 1.2.2 电容器型号命名方法 1.2.3 电容器的主要参数 1.2.4 电容器标识 1.2.5 电容器的简易测试 1.2.6 电容器使用注意事项 1.3 电感器 1.3.1 电感器的类别 1.3.2 电感器的主要参数 1.3.3 小型固定电感器的标识 1.3.4 电感器的简易测试 1.4 继电器 1.4.1 继电器的分类 1.4.2 有关继电器的名词及参数 1.4.3 常用继电器型号 1.4.4 固态继电器 1.5 半导体器件 1.5.1 半导体分立元件的命名 1.5.2 半导体二极管 1.5.3 半导体三极管 1.5.4 场效应管 1.5.5 光电耦合器 1.5.6 集成电路 1.5.7 机电元件 习题1 实训1 一、电阻器阻值的判读和检测 二、电容器标称值判读及电容容量比较 三、半导体二极管和三极管的简单测试2 手工焊接工艺 2.1 手工焊接工具 2.1.1 电烙铁 2.1.2 焊接辅助工具 2.1.3 电烙铁的维护与维修 2.2 焊料与助焊剂 2.2.1 焊料 2.2.2 助焊剂 2.3 元器件的筛选与成型 2.3.1 元器件的筛选 2.3.2 元器件引线成型 2.4 手工焊接 2.4.1 电烙铁的选用 2.4.2 电烙铁使用前的准备 2.4.3 焊点的质量要求 2.4.4 焊接的要领 2.4.5 焊接的步骤 2.4.6 几种常用工件的焊接 2.4.7 几种特殊工件的焊接 2.5 焊接质量的检查 2.6 拆焊 习题2 实训2 一、带锡焊接法 二、点锡焊接法 三、元器件的焊接 四、搭焊、钩焊和绕焊训练 五、手工贴片焊接 六、拆焊训练 七、贴片拆焊训练3 自动焊接工艺 3.1 印制电路板(PCB) 3.1.1 印制电路板的材料与类型 3.1.2 印制电路板的制作 3.2 浸焊与波峰焊 3.2.1 浸焊 3.2.2 波峰焊 3.2.3 二次焊接工艺 3.3 表面安装技术(SMT) 3.3.1 表面安装技术的特点 3.3.2 表面安装材料 3.3.3 SMT装配焊接技术 3.3.4 SMT元器件的基本要求 3.3.5 使用SMT元器件的注意事项 3.3.6 表面安装工艺 3.4 微组装技术(MPT) 3.4.1 微组装技术概述 3.4.2 微组装技术类型 3.4.3 微组装技术焊接 习题3 实训34 装配工艺基础 4.1 常用工具与材料 4.1.1 装配工具 4.1.2 装配设备 4.1.3 常用线材 4.1.4 绝缘材料 4.1.5 磁性材料 4.1.6 电工常用塑料 4.1.7 常用紧固件与线扎 4.1.8 常用粘接材料、油漆和有机溶剂 4.2 装配中的加工工艺 4.2.1 导线的加工 4.2.2 线扎加工 4.2.3 电缆导线的加工 4.3 装配中的安装工艺 4.3.1 螺装 4.3.2 铆装 4.3.3 粘装 4.3.4 压接 4.3.5 绕接 习题4 实训4 导线与电缆的加工训练5 常用技术文件及整机装配工艺 5.1 常用技术文件 5.1.1 概述 5.1.2 工艺文件的编制原则与要求 5.1.3 常用工艺文件的类型及填写 5.1.4 工艺文件的管理 5.2 整机装配工艺 5.2.1 装配准备 5.2.2 装配阶段 5.2.3 检验阶段 习题5 实训5 一、BJ-1八路数字显示报警器的装配 二、敲击武语言门铃的装配6 常用调试仪器 6.1 万用表 6.1.1 MF-47型万用表的表盘结构 6.1.2 测量原理 6.1.3 测量范围和指标 6.1.4 使用方法 6.1.5 注意事项 6.2 晶体管稳压电源 6.2.1 面板结构 6.2.2 主要技术指标 6.2.3 工作原理 6.2.4 使用方法 6.2.5 注意事项 6.3 信号发生器 6.3.1 低频信号发生器 6.3.2 高频信号发生器 6.3.3 函数信号发生器 6.4 示波器 6.4.1 面板结构图 6.4.2 主要性能指标 6.4.3 工作原理 6.4.4 使用方法 6.4.5 注意事项 6.5 晶体管毫伏表 6.5.1 面板结构图 6.5.2 主要性能指标 6.5.3 工作原理 6.5.4 使用方法 6.5.5 注意事项 6.6 频率特性测试仪 6.6.1 面板结构图 6.6.2 主要性能指标 6.6.3 工作原理 6.6.4 使用方法 6.6.5 注意事项 6.7 矢量示波器 6.7.1 前后面板控制器、连接器说明 6.7.2 主要技术指标 6.7.3 示波管内刻度说明 6.7.4 使用方法 6.7.5 注意事项 6.8 虚拟仪器 习题6 实训6 一、SR-8双踪示波器的使用训练 二、示波器、信号发生器、晶体管毫伏表混合使用训练7 调试技术 7.1 概述 7.2 调试的工艺文件 7.3 单元电路调试的方法 7.4 单元调试 7.4.1 静态调试 7.4.2 动态调试 7.5 整机调试 7.6 电子整机调试与检测举例 7.6.1 超外差式晶体管收音机的调试 7.6.2 彩色电视机的调试 习题7 实训7 一、收音机调试训练 二、高频特性曲线的调试训练(2频道) 三、中放特性曲线的调试训练 四、伴音鉴频S曲线的调试训练8 综合练习 8.1 电子设备装接工练习题及答案 8.1.1 中级工练习题 8.1.2 高级工练习题 8.2 无线电调试工练习题及答案 8.2.1 中级工练习题 8.2.2 高级工练习题附录 附录1 电子设备装接工国家职业标准(摘要) 附录2 无线电调试工国家职业标准(摘要) 附录3 无线电装接中级工理论考核试卷(2009年) 附录4 电子设备装接工中级操作技能考核试卷(2009年) 附录5 无线电调试工高级理论考核试卷(2009年) 附录6 无线电调试高级工操作技能考核试卷(2009年)参考文献

<<电子装配与调试工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>